

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成18年12月14日(2006.12.14)

【公開番号】特開2000-344940(P2000-344940A)

【公開日】平成12年12月12日(2000.12.12)

【出願番号】特願平11-314314

【国際特許分類】

C 08 K 5/5455 (2006.01)  
 C 08 L 79/04 (2006.01)  
 C 08 L 101/00 (2006.01)  
 G 03 F 7/075 (2006.01)

【F I】

C 08 K 5/5455  
 C 08 L 79/04  
 C 08 L 101/00  
 G 03 F 7/075 5 0 1

【手続補正書】

【提出日】平成18年10月26日(2006.10.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

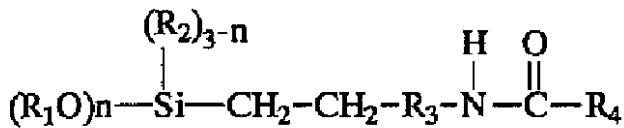
【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(I)で示される、200以上の成形温度が必要な樹脂成形用シリコン系カップリング剤。

【化1】



... (I)

[式中 R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>はそれぞれ独立に炭素数1～4のアルキル基、R<sub>3</sub>は2価の有機基、R<sub>4</sub>は-NH-R<sub>5</sub>または-O-R<sub>6</sub>から選ばれる基(式中R<sub>5</sub>、R<sub>6</sub>はCOOH基を含まない1価の有機基)、nは1～3の整数を示す]

【請求項2】 (i) 200以上の成形温度が必要な樹脂、及び(iii)請求項1記載のシリコン系カップリング剤を含有する樹脂組成物。

【請求項3】 (i) 200以上の成形温度が必要な樹脂が、ポリイミド前駆体、またはポリベンズオキサゾール前駆体である請求項2に記載の樹脂組成物。

【請求項4】 (i) 200以上の成形温度が必要な樹脂、(iii)請求項1記載のシリコン系カップリング剤、及び(iii)感光剤を含有する樹脂組成物。

【請求項5】 (i) 200以上の成形温度が必要な樹脂が、ポリイミド前駆体、またはポリベンズオキサゾール前駆体である請求項4に記載の樹脂組成物。

【請求項6】 (i) 200以上の成形温度が必要な樹脂が、ポリアミド酸エster、ポリイソイミド、ポリアミド酸及びその塩、並びにヒドロキシポリアミド樹脂からなる群から選ばれる一種以上の樹脂：100重量部、(ii)請求項1記載のシリコン系カップリング剤：0.1～20重量部、(iii)感光剤がo-キノンジアジド化合物：0

~100重量部(但し、前記(i)の樹脂がヒドロキシポリアミド、又はポリアミド酸およびその塩の場合には0ではない)、及び(iv)溶剤:70~1900重量部を含有する樹脂組成物。

【請求項7】 基材上に請求項2~6のいずれかに記載の樹脂組成物を塗布した後、乾燥により溶剤を揮散させ、その後200以上に加熱することにより得られる樹脂。

【請求項8】 基材上に請求項2~6のいずれかに記載の樹脂組成物を塗布した後、乾燥により溶剤を揮散させ、その後200以上に加熱することにより樹脂と基材とを一体化することを特徴とする樹脂の成形方法。